# 智能电表系统实现方案及其 发展趋势

在智能电网的诸多应用中,智能电表应用已率先落地。目前主流的智能电表方案有三种,而在成本压力下,未来SoC方案或将成为主流。

## ■ 韩明 费宇航 上海贝岭股份有限公司

自19世纪末第一只感应式电能 表用于电量计量以来,随着技术的 进步尤其是上世纪70年代以来大规 模集成电路的发展,电能表也由机 械式向电子式发展,目前电子式电 能表已基本取代了传统的机械式电 能表,并开始走向智能化。

2009年奧巴马上任美国总统后,为抵御金融危机、振兴经济,提出新能源战略,开始将智能电网上升到战略地位。2009年1月,奥巴马发布了《复苏计划尺度报告》,宣布将为4,000万美国家庭安装智能电表。英国宣布从2011~2020年对现有的4,700万只电表和气表进行升级。法国计划将现有3,500万只电能表更换为智能表。而意大利主要电

力运营商早已于2001~2004年间,安装和改造了3,000万只智能电表,建立了智能化计量网络,实现了全国95%电力用户电能信息的自动采集。欧盟要求到2020年将80%现有电表更新,约有1.45亿只。

在我国,2009年11月国家电 网公司发布了智能电表标准,拉开 了我国全面更换安装智能电表的序 幕,已集中招标智能电表2,000余万 只,预计在未来几年内投资380亿 元,安装1.3亿只智能电表。

## 智能电表的特点

智能电表不同于传统电表之处在于它要求实现双向实时通讯,具有互动的特征,能够提供实时数

与传统电表主要完成电能量计 量和显示相比,智能电表集测量、 通讯、微电子、数字信号处理和计 算机技术为一体。 在功能方面, 包 含电能计量、多功能电参量测量、 费率控制、预付费和负荷控制、数 据处理及存储、通讯、显示等。对 于电能计量芯片, 在国网新发布的 智能电表标准中,在功能方面除实 现基本的电能计量外, 还要求能够 测量电压、电流(火线及零线)、功 率、功率因数等电参量。而在性能 方面,要求具有更高的测量精度、 更宽的测量范围及更好的产品一致 性。以测量范围为例,以前的电 子式电能表通常要求500:1的测量

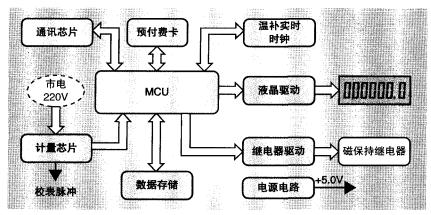


图1:智能电表原理框图

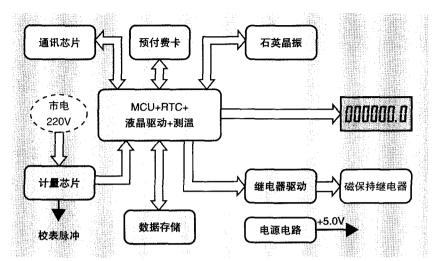


图2: 低成本智能电表方案框图

动态范围, 而满足国网标准的新一 代智能电表其动态范围至少要达到 1000:1,要求提高了一倍以上,同时 还对测量精度的一致性提出了具体 的要求。另外,由于智能电表在性 能方面要求的提高,各主要电表生 产企业纷纷上马电表自动生产线以 保证产品质量,因此,要求计量芯 片能够支持自动误差修正和调整, 实现自动校验。对于MCU, 除要求 具有较大的程序和数据空间外, 还 要求具有较高的时钟频率和丰富的 通讯及I/O口资源。电源方面应具有 多种节电模式和较低的功耗, 具有 低电压检测和硬件看门狗。同时, 能够集成LCD驱动、数字温度传感 器、A/D转换器及实时时钟(RTC)也 是设计者所希望的。

除计量和MCU芯片外,智能电表还需要数据通讯(PLC或RS-485)、高精度实时时钟、液晶驱动存储和符合国密算法的数据安全芯片等,国网新发布的智能电表标准中对这些都做了详细的要求和规定。

#### 智能电表的系统解决方案

图1是智能电表的原理框图, 由图可以看出,智能电表所需IC包 括多功能计量、MCU、通讯、带温补的高精度实时时钟、液晶驱动、数据存储及电源等。在设计中,由于计量部分要与MCU等其他部分隔离,因此目前的方案计量部分均采用单独的芯片,而方案的差异主要体现在液晶驱动、实时时钟的实现方式上。

目前的主流方案计量芯片通常采用上海贝岭的BL6523、深圳锐能 微RN8209及CS5464等,MCU则大 多采用NEC、瑞萨、飞思卡尔等国外品牌的产品,液晶驱动采用独立的140段以上驱动器,如上海贝岭的BL55070等,而实时时钟主要采用内置晶体和温度补偿的单芯片方案,如EPSON的RX8025T。

由于国网初期招标低价中标政 策的推行,各电表企业为求市场份 额纷纷低价投标,成本压力不断加 大,为此复旦微电子和意法半导体 等推出了在MCU中集成液晶驱动体 实时时钟等单元的方案,系统框图 如图2所示。在这类方案中,更主图 MCU中集成了液晶驱动外,更主要 的特点是集成了实时时种和测温电 路,并加上高性能的外置石英振落 器以取代价格较高的单片带温度补 偿的实时时钟。方案中的内置RTC具有数字补偿功能,可对外置晶振带来的误差进行补偿,同时,用内置的温度传感器又可对晶振的温度曲线进行补偿,以保证全温度范围实时时钟的精度满足标准的要求。该方案可明显降低整体IC的成本,具有较高的性价比。

借鉴第二种方案的实时时钟实现方式,目前有企业考虑在第中,不含温补可的一种方案中,采用外置品不含温补取取代价格较高的单片时钟。该方案也具有更好的,可以保证全温度或对的,可以保证全温度或求证,可以保证全温度或求证,可以保证有更为的,是有关的性价比,而MCU则可以有更多的选择。

#### 智能电表未来发展趋势

智能电表正向着多功能、智 能化、实时互动化的方向发展,但 目前所采用的PLC方案在实时性方 面还难以达到要求, 因此, 先进的 可满足实时通讯要求的PLC芯片是 各芯片厂商产品研发的重点。另一 方面,随着智能电表成本压力的加 大, SoC将是各芯片企业的另一个追 逐重点。前期由于国内电力部门对 SoC产品的可靠性尚存疑虑及在性价 比方面并未显现出明显的优势, 因 此,SoC产品除个别企业在出口产品 中使用外, 在国内市场一直没有需 求;而随着SoC产品的不断成熟和智 能电表成本压力的日趋加大,已有 许多电表生产企业在探讨采用SoC产 品的可行性,同时,更多的芯片公 司正在定义和研发各自的SoC产品。 贝岭已规划了PLC和SoC产品并已开 始投入研发,预计2011年将有产品 推出。■